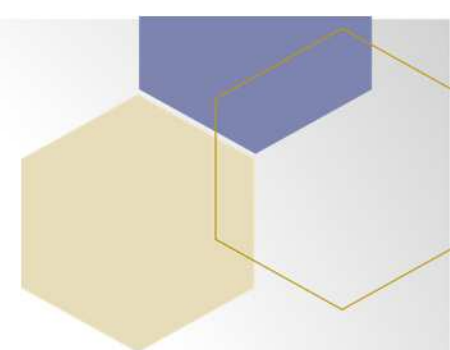
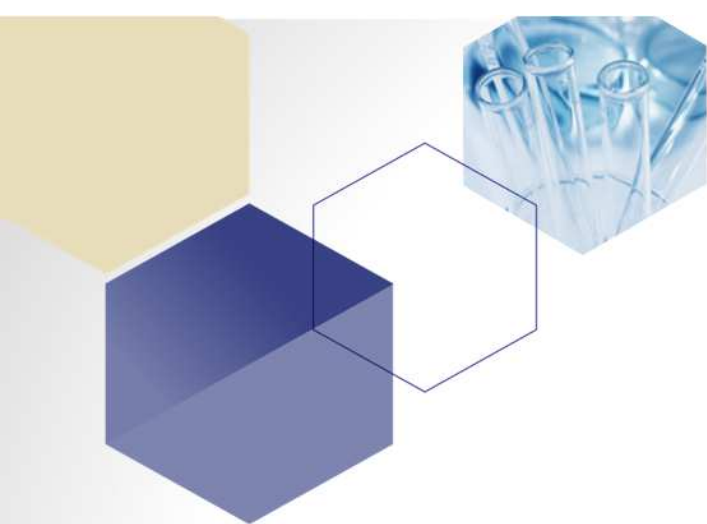




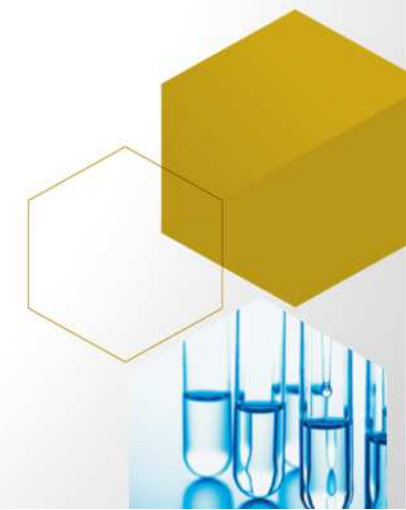
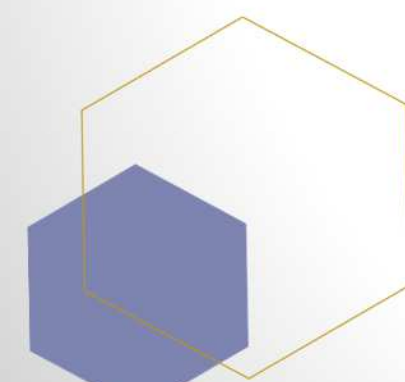
2025年 3 月期 決算説明資料

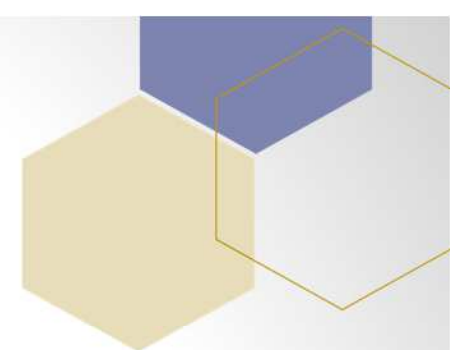
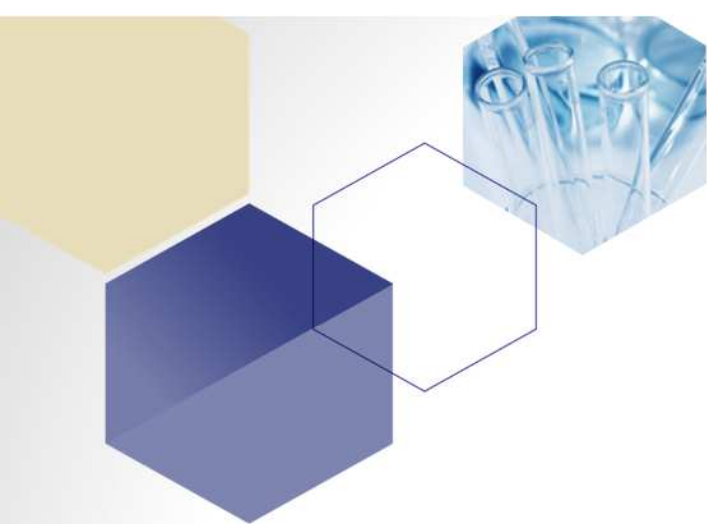


日本高純度化学株式会社

証券コード：4973

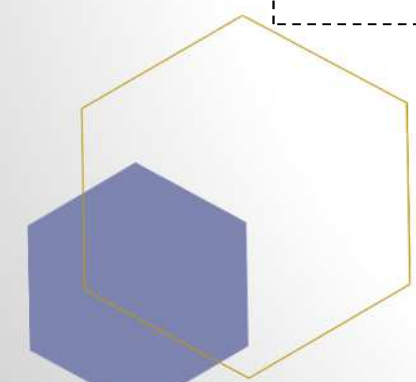
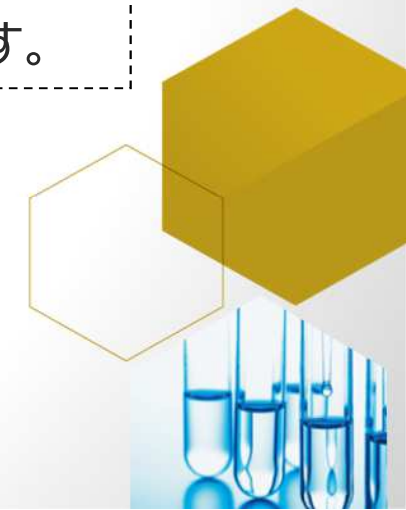
2025年4月25日





決算の概況

(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合によって大きく変動します。
 - 貴金属は価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 
- 

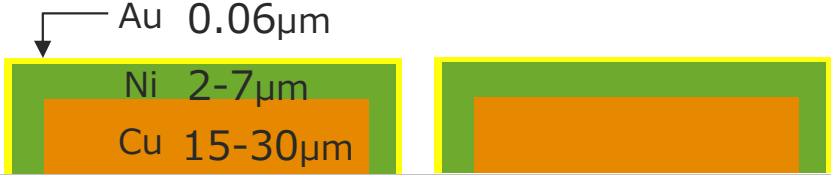
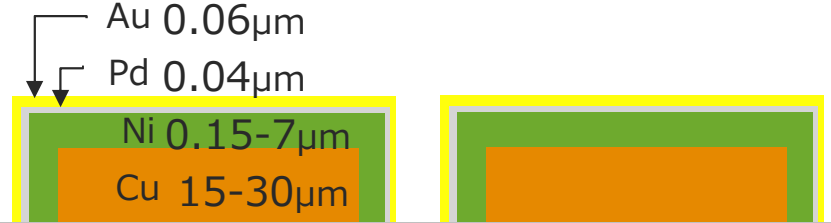
めっき方式の説明

用語	最終用途	説明
電解めっき	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	PC・スマホ等のプリント基板（CPU・GPU等）	高純度な純金めっき
硬質金めっき	スマートフォン・車載・産業機械等のコネクタ	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウムめっき	PC・車載・産業機械等のリードフレーム	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換金めっき	DRAM・NAND等の半導体メモリ サーバー・PC・スマートフォン等の半導体搭載基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元金めっき	半導体搭載基板 サーバー・PC等のCPU・GPU等	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法
還元パラジウムめっき	サーバー・PC等の半導体搭載基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法（金めっきの下地として使用される）

製品ラインアップ

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	テンペレジストシリーズ
	硬質金		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元パラジウム		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル）、合金めっき、後処理剤など	

めっきプロセスの説明

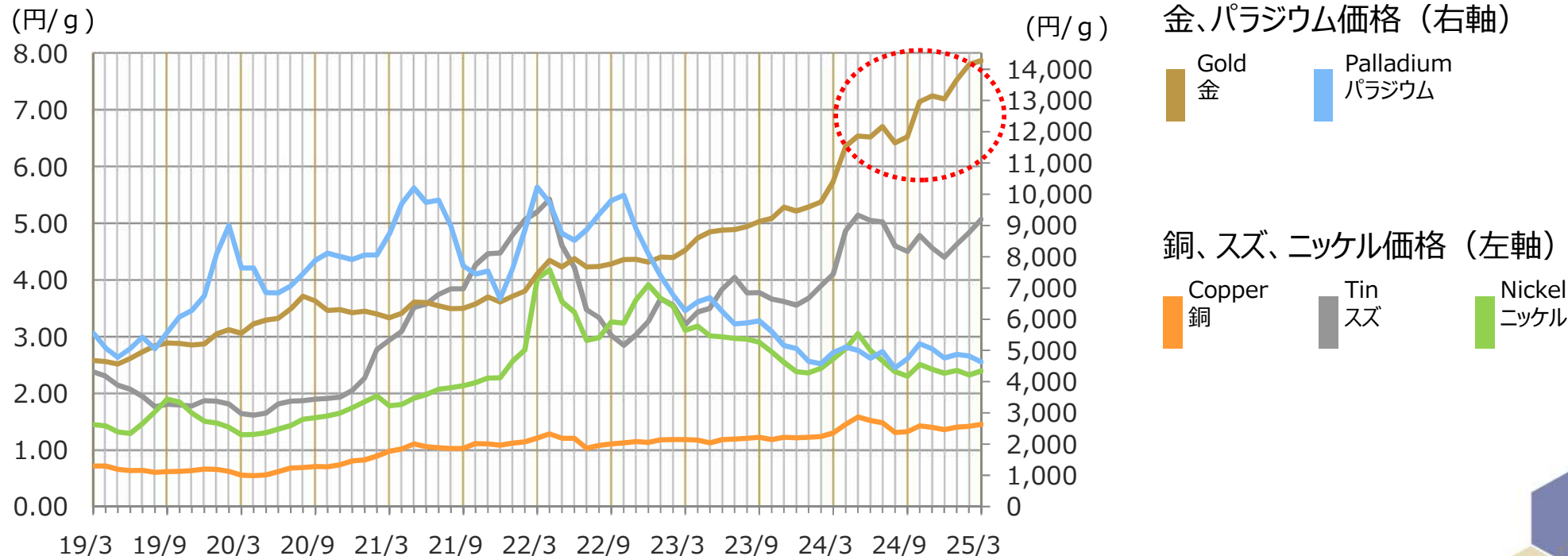
用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Ni-Au Electroless Nickel Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Ni 2-7μm Cu 15-30μm
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法 薄ニッケル化の動きが進んでいる。 層構成はCu-Ni-Pd-Au Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Pd 0.04μm Ni 0.15-7μm Cu 15-30μm
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。 層構成はCu-Au Direct Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Cu 15-30μm
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Pd-Au Electroless Palladium Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Pd 0.04μm Cu 15-30μm

2025年3月期 外部環境

電子部品業界の状況

- 生成AI向けの旺盛な需要に牽引されAIサーバ/データセンター向けは好調に推移したが、スマートフォンやパソコンなどの民生向けは需要回復に足踏み感がみられ、FA機器などの産業機器向けは在庫調整の長期化により低迷
- 車載用電子部品については、先進運転支援システムなどの電装化による継続的な需要増はあったが、電気自動車の成長鈍化による在庫調整から停滞

貴金属の概況



2025年3月期 決算概況

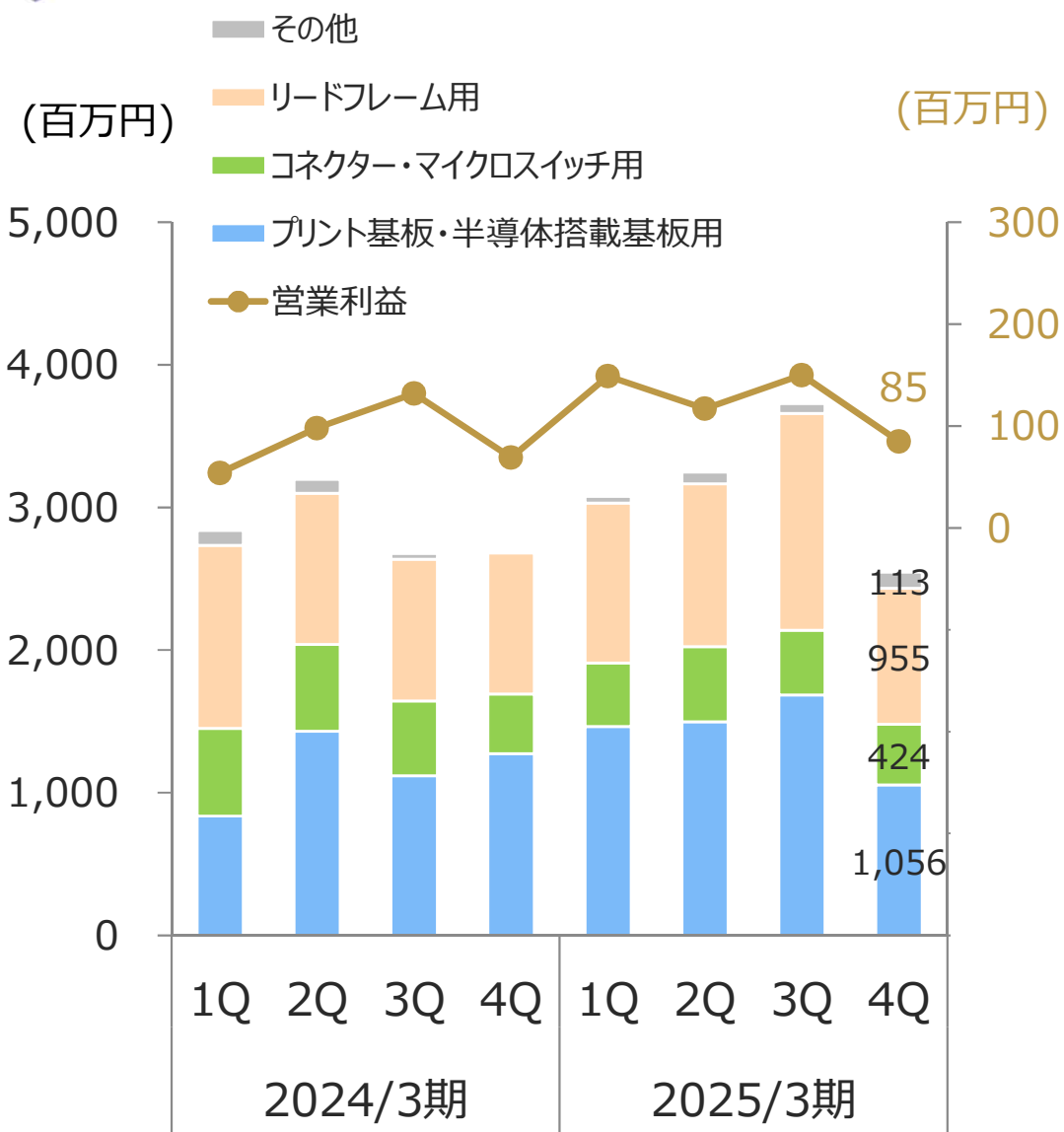
当社の決算概況

- 4Q：スマートフォン・パソコンなどの需要減速に伴う顧客の在庫調整を主因に減収
- 通期：生成AI関連は好調でスマートフォン向けも緩やかに回復した一方、車載向けが下期に減速、産機向けの市場低迷を受けて、営業利益は10月公表値通りの着地
- 前年比：販売量の増加等により+10.4%増収、営業利益は+41.8%の増益
- 純利益は、保有株式の売却益を計上したことで大幅増益

(単位：百万円)

	2024/3期 通期合計	2025/3期							
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計	増減率	24/10公表	公表比
売上高	11,419	3,079	3,251	3,731	2,549	12,611	+10.4%	13,000	97.0%
営業利益	354	149	117	150	85	502	+41.8%	500	100.5%
経常利益	553	241	118	203	93	657	+18.8%	680	96.6%
四半期純利益	548	271	550	509	247	1,579	+188.1%	1,580	99.9%
1株当たり 四半期純利益	95.26円	47.09円	95.42円	88.25円	42.93円	273.73円	—	—	—

売上高・営業利益の推移

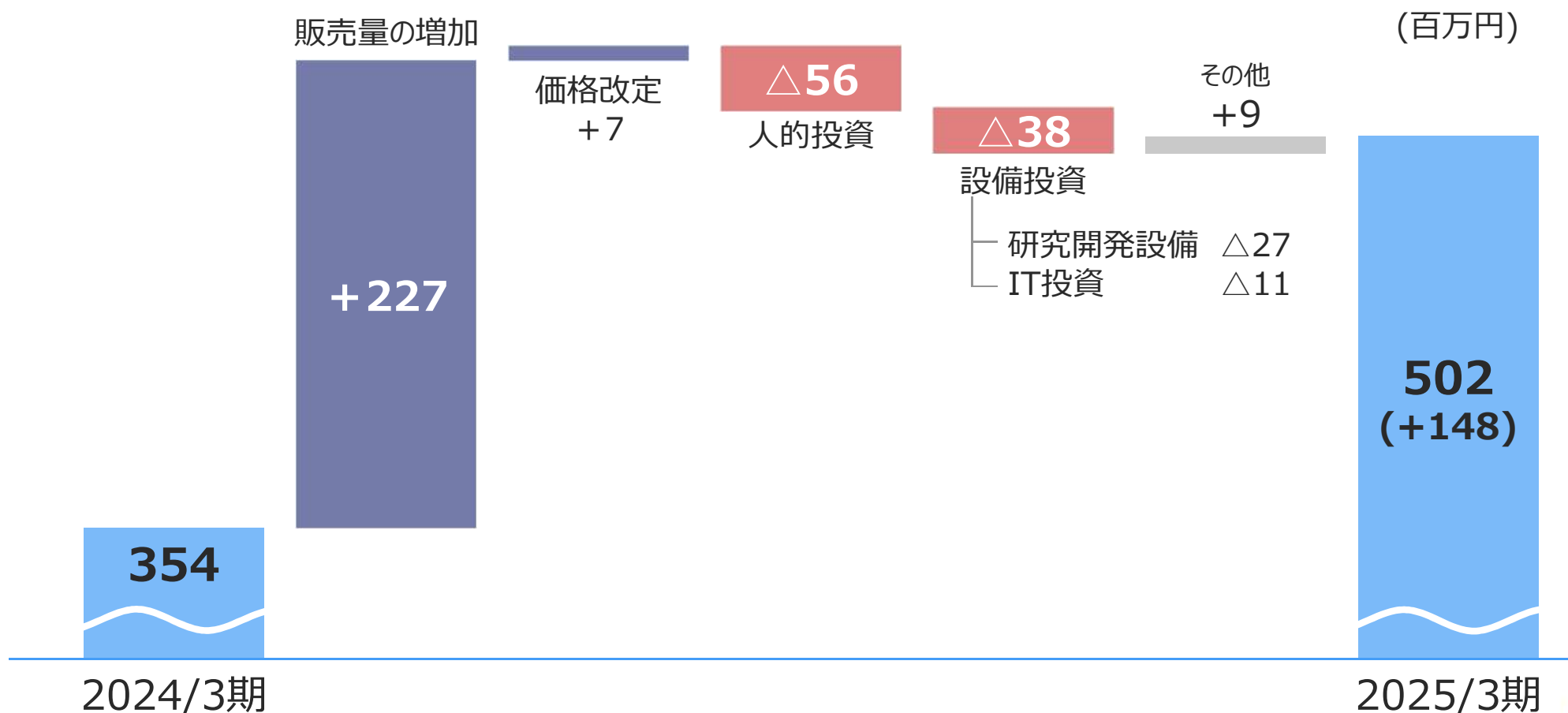


カテゴリー別概況（通期）

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
スマートフォンやパソコンなどの民生向けは下期に市場減速の影響を受けたが緩やかに回復し、生成AI関連の半導体パッケージやモジュール向けは好調に推移し増収
- コネクター用めっき薬品
当社製品の優位性（省金効果）からスマートフォン向けで堅調に推移。車載向けは在庫調整の影響を受けて減速したうえ、産業機器向けで引き続き市場が低迷し減収
- リードフレーム用めっき薬品
当社製品の品質安定性が評価され、スマートフォンやパソコン向けで底堅く推移し増収

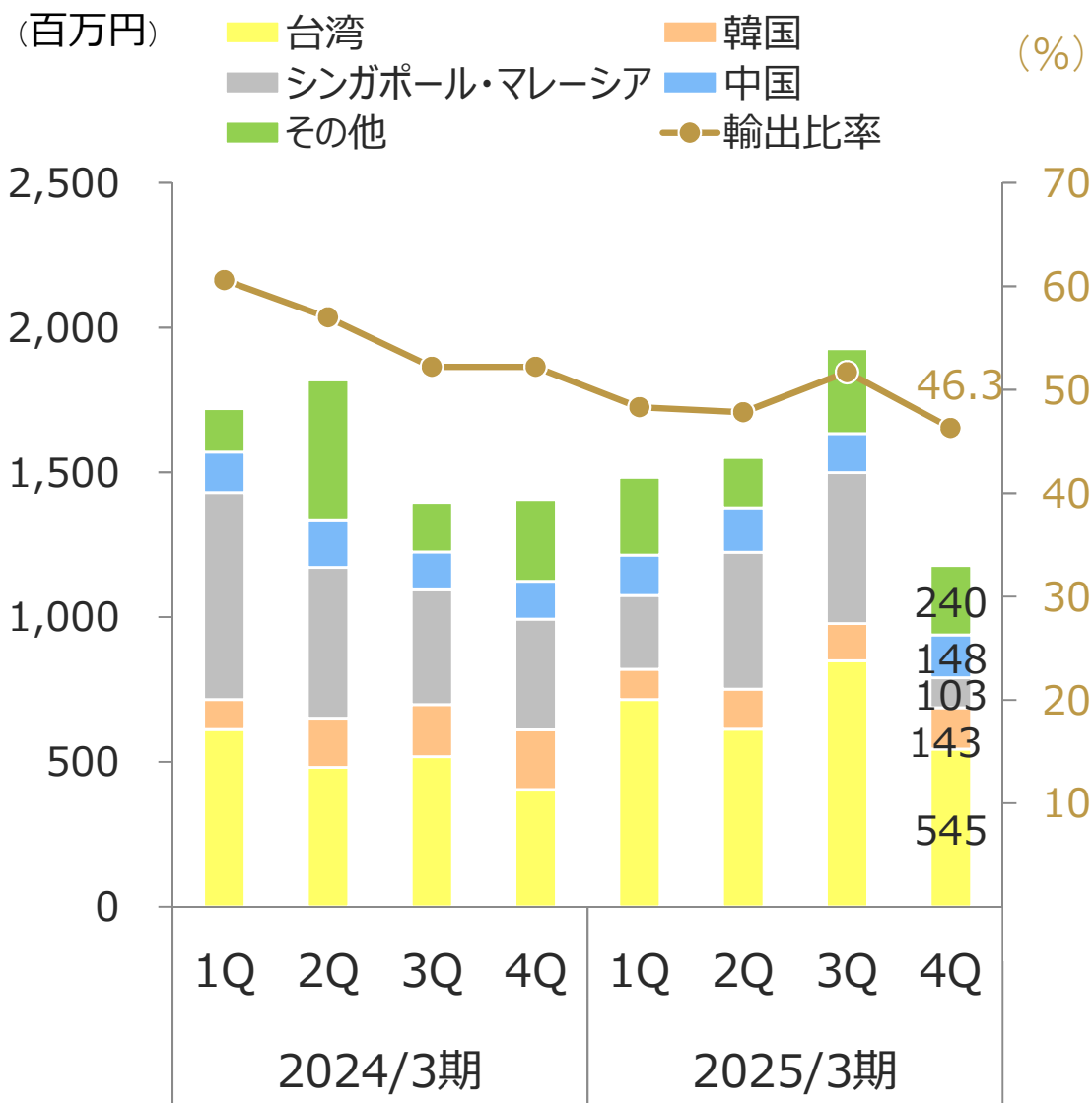
営業損益増減要因（前年比）

- 販売量の増加・価格改定に伴い、前年比234百万円の増益
- 積極的な成長投資（人的投資56百万円、研究開発設備投資38百万円等）を実施



注) 当社は為替予約により為替変動の影響を最小限に留めています。

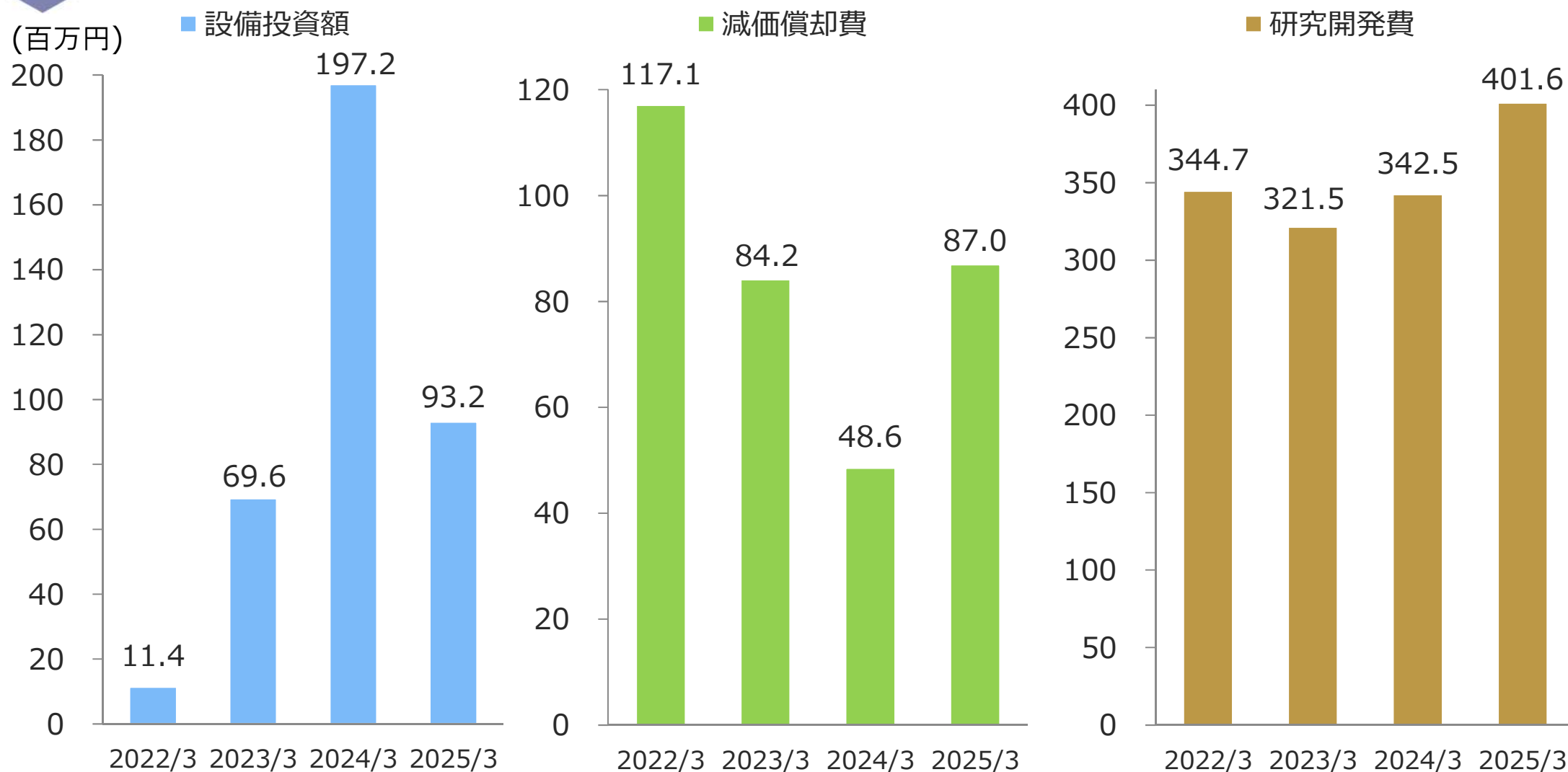
輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



増減理由

- 台湾
スマートフォン・パソコン向けリードフレーム用途で当社製品の品質安定性が評価され、3Qにおいては増収
- シンガポール・マレーシア
4Qでスマートフォン・パソコン向けリードフレーム用途が不調

設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



● 2025/3期の主な投資 : HP更新 12百万円 プラズマ処理装置 9百万円

● 2026/3期の主な投資予定 : CRM 80百万円 ICP分析装置 15百万円

2026年 3 月期 見通し

- サーバ/データセンター向けは生成AI向けの旺盛な需要増に牽引され堅調な推移を予想
- スマートフォンやPC等の民生品向けは緩やかな需要回復を予想
- 車載向けは電気自動車の需要鈍化による在庫調整長期化の懸念があり、産業機器向けは本格的な回復時期が依然として見通せない状況が継続
- 先行投資による費用増で利益は微増に留まる
- アメリカの貿易政策が世界経済に与える影響は含まず

(単位：百万円)

	2025/3期	2026/3期	前期比
売上高	12,611	14,000	+11.0%
営業利益	502	510	+1.5%
経常利益	657	670	+1.9%
投資有価証券売却益	1,512	未織込	—
当期純利益	1,579	500	△68.3%
配当	126円	126円	+0円
ROE	11.3%	3.7%	—
DOE	5.2%	5.4%	—

政策保有株式売却の進捗

- 当社は政策保有株式について、純資産割合を20%未満に縮減する方針を掲げています。
- 上記方針に沿って、2024年度において1,722百万円の売却を実施した結果、純資産に対する割合は40%台前半に低下しています。

	2024年 3月末	2024年 6月末	2024年 9月末	2024年 12月末	2025年 3月末	2024/3比
売却額 ※（百万円）	307	142	752	553	275	－
保有株式時価（百万円）	8,796	9,069	7,236	7,108	5,974	2,822減
純資産額（百万円）	14,537	14,683	14,052	14,149	13,594	943減
純資産に対する割合（%）	60.5	61.8	51.5	50.2	43.9	16.6pt減

※ 該当四半期中での売却額

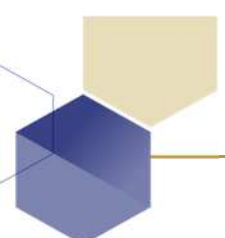
補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7 月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3 月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3 月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2 月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4 月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4 月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを保有しないファブライト企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2025年3月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>